PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-311155

(43)Date of publication of application: 15.12.1989

(51)Int.Cl.

CO8L 27/12

COSL 79/08

F16J 15/20

(21)Application number : 63-141276

1276 (71)Appl

(71)Applicant : NITTO DENKO CORP

(22)Date of filing:

08.06.1988

(72)Inventor: HONDO MAMORU

MIZOBE KEIZO MOCHIZUKI SHU

(54) SEALING MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a sealing material excellent in abrasion resistance even under conditions in the absence of a lubricant by mixing a spherical aromatic polyimide powder having a specific average particle diameter and particle size distribution with polytetrafluoroethylene, premolding the resultant mixture and calcining the molded product.

CONSTITUTION: A sealing material obtained by mixing polyimide powder, prepared by reacting an aromatic tetracarboxylic acid dianhydride with an aromatic diamine, producing a polyamic acid having 0.1–1.2, preferably 0.3–0.8 inherent viscosity and converting the resultant polyamic acid into an imide and having a spherical shape, 3–15μm, preferably 5–10μm average particle diameter, 0.1–50μm, preferably 1–30μm particle size distribution and preferably ≥350° C heat distortion temperature in an amount within the range of 1–50wt.%, preferably 5–30wt.% with (B) powdery polytetrafluoroethylene, homogeneously dispersing the resultant mixture, premolding the obtained dispersion into a desired shape, calcining the premolded product at 360–380° C and cutting the calcined product.

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平1-311155

⑤Int. Cl. 4 識別記号 庁内整理番号 L G E L R C 27/12 C 08 L 7445-4 J 79/08

❸公開 平成1年(1989)12月15日

F 16 J 15/20 8830-4 J 7369-3 J 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全7頁)

69発明の名称 シール材

> ②特 願 昭63-141276

22出 昭63(1988)6月8日

@発 明 者 本 堂 守 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会

社内

個発 明 溝 敬 Ξ 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会 者 部

社内

明 月 周 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号 日東電気工業株式会 @発 者 望

补内

日東電工株式会社 @出 願人 大阪府茨木市下穂積1丁目1番2号

明 細 43

1.発明の名称

シール材

2. 特許請求の範囲

(1) 平均粒径 3~15 µm、粒度分布 0.1~50 μ m の球状形状を有するポリイミド粉末1~50 **重量%が、ポリテトラフルオロエチレン中に均一** に分散含有され、且つ焼成されていることを特徴 とするシール材。

3. 発明の詳細な説明

<産業上の利用分野>

本発明はシール材に関するものであり、詳しく は特定のポリイミド粉末をポリテトラフルオロエ チレン中に均一に含有させることによって、無潤 滑翔条件下でも極めて良好な耐摩託性を発揮する シール材に関するものである。

<従来の技術>

従来からポリテトラフルオロエチレン(以下、 PTFEという) は低摩擦特性に優れているので 潤滑剤を必要としないシール材として好適に使用 できるものである。

しかし、PTFBは耐摩耗性、耐圧縮クリープ 特性が他の樹脂と比べて極めて劣るので、PTF Bを用いたシール材には通常、ガラス繊維やカー ボン繊維などの繊維状物が充填され、上記PTF Eの欠点を補っている。

これら繊維状物を充填したシール材では相手材 としてアルミニウムや真鍮、銅などの軟質金属に 使用した場合、繊維状物と金属の接触により金属 が損傷され、その結果損傷金属が逆にシール材を 削り取りシール材の摩耗度が大きくなるという欠 点を有している。また、摩耗度が大きくなると摩 療係数が非常に不安定となり、例えば圧縮機のシ ール材として用いた場合に発熱を伴い、時にはP TFBの軟化点以上に発熱してクリーア変形や相 手材への焼き付き現象を生じる。このような現象 は特に、高荷重、高速下での乾式すべり摩擦で競 習に現れるものである。

近年、シール材としてのPTFEの耐摩耗性を 向上させ、軟質金属などの相手金属を損傷させな

. 特問平1-311155(2)

いような充塡剤としてグラファイト、二硫化モリブデンなどの固体の無機系充塡剤や、ポリエーテルスルホン、オキシベンゾイルポリエステル、ポリアミドイミド、ポリエーテルケトンなどの耐熱 性の有機系樹脂粉末が用いられている。

しかし、無機系充填剤は摩耗量が有機系充填剤 と比べて多く、決してシール特性が充分であると は云えないものである。また、上記有機系の塩 剤は通常、良好な耐摩耗性を示すが、高荷重以上に 発熱して熱変形やクリープ変形を生じ、摩擦 の増大に伴い耐摩耗性も悪くなるという傾向を示 し、圧縮機のシール材として使用するとシール特 性が低下し、且つ耐久性にも劣るという欠点を有 している。

さらに、有機系の充填剤として芳香族系ポリイミドフィルムをフィルム粉砕機にて粉末状としたものも提案されているが、このようにして得られるポリイミド粉末は平均粒径が10~40μmで粒度分布が0.5~300μmとバラツキが大きく、

また粒子形状も扁平状や球状、繊維状など非常に 不揃いのものである。従って、このような初末を 充塡してなるシール材は滑り特性が悪く摩擦係数 も大きくなるので、摩耗量が多くなる傾向を示し、 シール材として満足できるものではない。

<発明が解決しようとする課題>

上述のように従来のシール材では無機系や有機 系の各種充塡剤を用いているが、耐摩耗性におい て充分満足できるものではなく、250で以上、 特に300で以上の高温になるとクリープ変形を 起こし、耐摩耗性やシール性、耐久性に劣るとい う問題点を有するものである。

本発明はこのような実情に鑑みてなされたものであり、充填剤として特定の粉末特性を有する全芳香族系ポリイミド粉末を用い、PTFEをベース樹脂とするシール材であって、適度な硬度を有し耐摩耗性に優れ、しかも高温条件下でも優れた耐摩耗性、耐クリーブ性、シール性などを示すシール材を提供することを目的とする。

<課題を解決するための手段>

本発明者らは上記目的を達成するために鋭意検 討を行った結果、充塡剂として用いるボリイミド 粉末に特定の平均粒径および粒度分布を有する球 状形状を有する芳香族ポリイミド粉末をPTFE に混合物し、シール材として予備成形したのち焼 成することによって、上記問題点を解決した優れ たシール材が得られることを見い出し本発明を完 成させるに至った。

即ち、本発明は平均粒径3~15μm、粒度分布0.1~50μmの球状形状を有するポリイミド粉末1~50重量%が、ポリテトラフルオロエチレン中に均一に分散含有され、且つ焼成されていることを特徴とするシール材に関するものである。

本発明において充塡剤として用いるポリイミド 粉末は、代表的には芳香族テトラカルボン酸二無 水物と芳香族ジアミンを反応させポリイミドの前 駆体であるポリアミド酸を合成して、さらにイミ ド転化を行なうことにて得られる全芳香族系のポ リイミドである。

該芳香族テトラカルポン酸二無水物としては、

例えばピロメリット酸、3,3',4,4'-ピフェニルテ トラカルボン酸、2,3,3',4'-ピフェニルテトラカ ルボン酸、1,2,4,5-ナフタレンテトラカルボン酸、 1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸、2,3,6,7-ナフタレンテトラカルポン酸、3,3',4,4'-ベンゾ フェノンテトラカルボン酸、2,2-ピス〔4-(2,3-ジカルポキシフェノキシ) フェニル) プロパン、 4,4'- ピス(2,3- ジカルボキシフェノキシ) ジフ ェニルエーテルなどのテトラカルボン酸の二無水 物や、これらの酸化物、低級アルキルエステル化 物、多価アルコールエステル化物などが挙げられ、 これらは単独でも二種以上を併用してもよい。な お、本発明では上記芳香族テトラカルボン酸二無 水物は、その一部を1,2,3,4-ブタンテトラカルボ ン酸二無水物の如き脂肪族テトラカルボン酸二無 水物の任意の量にて置換して使用することもでき

また、上記芳香族テトラカルボン酸二無水物と 反応させる芳香族ジアミンとしては、例えば4.4° ・ジアミノジフェニルエーテル、3.3°・ジメチル

-4, 4'- ジアミノジフェニルエーテル、3,3'- ジ メトキシ-4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3. 3'- ジアミノジフェニルエーテル、3,4'- ジアミ ノジフェニルエーテルなどのジフェニルエーテル 系ジアミンまたはこれらのチオエーテルなどのジ フェニルチオエーテル系ジアミン、4.4'・ジアミ ノベンゾフェノン、3,3'- ジメチル-4,4'-ジアミ ノベンゾフェノン、3,3' - ジアミノベンゾフェノ ンなどのベンゾフェノン系ジアミン、3,3'- ジア ミノジフェニルメタン、4.4'- ジアミノジフェニ ルメタン、3,3' - ジメチル-4,4' - ジアミノジフェ ニルメタンなどのジフェニルメタン系ジアミン、 2.2'- ピス(4- アミノフェニル) プロパン、2.2' - ピス(3- アミノフェニル) プロパンなどのピス フェニルプロパン系ジアミン、4,4'- ジアミノジ フェニルスルホキシド、3,3'- ジアミノジフェニ ルスルホキシドなどのジフェニルスルホキシド系 ジアミン、4.4'・ジアミノジフェニルスルホン、 3.3'- ジアミノジフェニルスルホンなどのジフェ ニルスルホン系ジアミン、ベンチジン、3,3'- ジ

メチルベンチジン、3.3' - ジメトキシベンチジン、 3.3'- ジアミノピフェニルなどのピフェニル系ジ アミン、2.6. - ジアミノピリジン、2.5. - ジアミ ノピリジン、3.4.- ジアミノピリジンなどのピリ ジン系ジアミン、o-, m- またはp-ジアミノベンゼ ン、3,5-ジアミノ安息香酸など、4,4'- ジ(m- ア ミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、4.4'- ジ (p- アミノフェノキシ) ジフェニルスルホン、4. 4'- ジ(ロ- アミノフェノキシ) ジフェニルエーテ ル、4.4'- ジ(p- アミノフェノキシ) ジフェニル エーテル、4.4'- ジ(n- アミノフェノキシ) ジフ ェニルプロパン、4.4'- ジ(p- アミノフェノキシ) ジフェニルプロパン、4.4'- ジ(m- アミノフェニ ルスルホニル) ジフェニルエーテル、4,4'- ジ(p - アミノフェニルスルホニル) ジフェニルエーテ ル、4,4'- ジ(m- アミノフェニルチオエーテル) ジフェニルスルフィド、4.4'- ジ(p- アミノフェ ニルチオエーテル) ジフェニルスルフィド、4.4' - ジ(m- アミノフェノキシ) ジフェニルケトン、 4.4'- ジ(p- アミノフェノキシ) ジフェニルケト

ン、4.4'- ジ(n- アミノフェノキシ) ジフェニルメタン、4.4'- ジ(p- アミノフェノキシ) ジフェニルメタン、2.5-ジアミノトルエン、2.4-ジアミノキシレン、ジアミノジュレン、1.5-ジアミノナフタレン、2.6-ジアミノナフタレンなどが挙げられる。これらのジアミンは単独で用いても二種以上併用してもよい。また、脂肪族ジアミンを上記芳香族ジアミンの一部に置換して使用することもできる。

前記芳香族テトラカルボン酸二無水物と芳香族ジアミンとの反応溶媒となる有機極性溶媒としては、N-メチル-2-ピロリドン、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、ヘキサメチレンホスホルトリアミド、ピリジンなどの溶媒ならびにクレゾール、フェノール、キシレノールなどのフェノール類が挙げられる。また、上記溶媒と共にヘキサン、ベンゼン、トルエン、キシレン、アルコール類などの有機溶媒を併用してもよい。

本発明における充塡剤としてのポリイミド粉末

は、例えば下記のような方法によって得ることが できる。

上記反応におけるイミド化前に得られるポリアミド酸の対数粘度は 0.1~1.2 (30 ℃、0.5 g / 100 mlジメチルアセトアミド (以下 D M A c という)中)、好ましくは 0.3~0.8 の範囲に調整することによって、対数粘度が 0.1~0.5 (3

特開平1-311155(4)

0 で、0.5 g / 1 0 0 ml 混硫酸中) の低分子量のポリイミドが得られる。また、同様の理由から回転粘度計 (B型) による溶液粘度を 1 ~ 5 0 ポイズ (ポリマー濃度 7.5 重量 %、30 で)、好ましくは 5 ~ 2 0 ポイズの範囲に調整する。

本発明では粘度、特に対数粘度を調節することが重要であり、調節するためにはポリアミド酸溶液に水やメタノールの如き溶剤を添加してポリアミド酸を加水分解する方法や、ポリアミド酸溶和を100℃以下の温度で加熱する方法などを用いることができるが、目的とするポリイミド粉末の粒径や粒度を再現性よく揃えるためには、モノマー配合量を厳格に調節して反応させることが好ましい。

また、反応系の熱分布が均一になるようにしてイミド化反応をスムースに行なって本発明のポリイミド粉末を得るために、反応時の攪拌速度を50~400rpm、好ましくは100~300rpmの範囲とし、反応時のモノマー濃度を5~50重量%、好ましくは10~30重量%の範囲とする。

ン- 7 およびその酸錯体の如き第三級アミンをポリアミド酸の各々のアミド基に対して第三級アミンを 0.5~1.5 モル%の範囲で添加することができる。さらに、反応時にアニリンや無水フタル酸の如き分子類末端基形成化合物を 0.2~30 モル%の範囲で添加することによって分子量を調節できるので、望ましい特性を有するポリイミド粉末を得ることができる。

また、本発明においてイミド化反応を促進させ て反応時間を短縮化し効率よくポリイミド粒子を 得るために、ピリジン、2-クロロピリジン、2. 4. 6-コリジン、2. 6-ジクロロピリジン、 リジン、2-プロピルピリジン、2、4-ルチジ ン、2、5-ルチジン、2、6-ルチジン、3. 4-ルチジンなどのピリジン類、トリエチルアミ ン、トリメチルアミン、N. N-ジメチルドデシ ルアミン、トリエチレンジアミン、トリーn-ブ チルアミンなどの脂肪族第三級アミン類、1-ベ ンジルー2ーメチルイミダゾール、1ーシアノエ チルー2-メチルイミダゾール、1-シアノエチ ルー2-フェニルイミダゾール、1-シアノエチ ルー2-エチルー4-メチルイミダゾール、1-シアノエチルー2ーウンデシルイミダゾール、な どの活性水素を有しないイミダゾール類、N. N -ジメチル-p-トルイジン、N. N-ジメチル ベンジルアミンなどの芳香族系第三級アミン類、 1, 8 - ジアザビシクロ (5, 4, 0) ウンデセ

材の比重も真比重に対して低くなり、シール材の 強度および伸びが低下して摩耗量が増大する。一 方、50μmを超えるとポリイミド粉末の平均粒 径が大きく空隙の多い凝集体となりやすく、均一 な分散ができず凝集体を含んだシール材となり、 比重も低くなりその結果、強度や仲びが低下して 摩耗量が増大する傾向を示す。

さらに、シール材として使用した際に生じる発 熱に対する耐熱性の点から、上記ポリイミド粉末 は350 で以上の熱変形温度を有するものが好ま しく、構造的には脂肪族テトラカルポン酸二無水 物や脂肪族ジアミンを用いない全芳香族系ポリイ ミドがよい。

本発明のシール材に使用するPTFEは、
- (CF = - CF =) - で表される繰り返し単位を主要構造とし、一般にポリフロンM - 1 2 . M
- 3 1 (ダイキン工業社製) 、テフロンT - 7 J. T - 8 2 0 - J (三井フロロケミカル社製)
などで市販されているものが好適に用いられる。

また、本発明において上記PTFEはポリイミ

ド粉末と混合して予備成形用の成形体とされるので粉末状として用いることが好ましく、機械的強度の低下の原因となるホワイトスポット (白斑) がシール材に発生することを防止するために、10メッシュのふるい機を通過する粉末が特に好ましい。

本発明のシール材は機械的特性や耐摩耗性を自 上させるために、上記ポリイミド粉末を1~50 重量%の好ましくは5~30重量%のでPP FEと乾式混合、もしくは湿式混合にでPP 合分散させ、圧縮成形、ラム押出成形、大体、スリープ状やピストンリング状なの所 での形に予備成形し、をののち360~380 程度の温度条件の焼成炉にて焼成、切削加工により所望のシール材を作製する。

このようにして得られる本発明のシール材は機 械的強度や伸び、耐摩耗性の向上の点から動摩擦 係数が 0.1 ~ 0.3 の範囲で、伸びが 5 0 %以上、 さらには 1 0 0 %以上のものが好ましく、このよ うな特性を有するものはシール材として使用した 場合の相手材との結着性や耐摩耗性、シール性の 点で好ましいものである。

<発明の効果>

以上のように本発明のシール材は、特別でのように本発明のシール材は、特別での主要のでするポリイミられて、 さらのであるのであるのであるのであるのであるのであるのであるのである。 飲食れたシール材として、 一次では、 一次では、

<実施例>

以下に本発明の実施例を示し、さらに具体的に 説明する。

実施例1~3

PTFE (ポリフロンM-12. ダイキン工業 社製)をミキサーにて粉砕し、さらに10メッシュの篩を通過したものに、ピロメリット酸二無水物および4.4'-ジアミノジフェニルエーテルから得られた平均粒径10μm、粒度分布3~20μm、対数粘度0.3(30℃、0.5g/100ml。硫酸中)のポリイミド粉末を充填剤として10重型%、20重量%、30重量%配合して、それぞれ実施例1~3とした。

混合はヘンシェルミキサーにて行ない、圧縮成 形機にて室温下、圧力 500 kg/cdで 5分間雑持し、 $\phi80 \times \ell120$ の予備成形品を作製し、これを 370 でにて焼成し、本発明のシール材を得た。

比較例 1

充填剤としてのポリイミド粉末を配合しなかった以外は実施例1と同様にしてシール材を得た。 比較例2

充塡剤としてのポリイミド粉末の配合量を60

重量%とした以外は実施例1と同様にしてシール 材を得た。

比较例3~6

充填剤としてグラファイト、炭素繊維、ポリイミド粉末(組成は実施例と同じ、フィルムからの粉砕品、平均粒径5~15μm、粒度分布0.5~50μm、非球状)、ポリイミド粉末(組成は実施例と同じ、フィルムからの粉砕品、平均粒径15μm以上、粒度分布50μm以上、非球状)をそれぞれ15重量%配合した以外は実施例1と同様にしてシール材を得、比較例3~6とした。

上記各実施例および比較例にて得られたシール 材の摩耗量、相手材の摩耗量、線膨張係数、シー ル性 (油漏れ量)、伸び、動摩擦係数を下記の方 法に従って測定し、その結果を第1 衷に示した。

また、第2図には実施例2、比較例3~5にて 得られたシール材のシール性(油湖れ量)の経時 変化を示した。

(シール材の摩託量および相手材の摩託量)

松原式摩擦摩託試験機 (オリエンテック社製)

特開平1-311155(6)

を用いて、圧力 (P) 5 kg / cd、速度 (V) 2 m / 秒、相手材アルミニウム板 (JIS 5056. 表面担さ (R_e) 3 µ m) の条件にて 2 時間の摺動 試験を行なって測定した。

(線膨張係数)

TMA 測定装置(セイコー電子社製)を用いて 昇温速度 5 セ/分にて測定し、5~150 でまで の線影張係数を測定した。

(シール性)

第1図に示すようにアルミニウム軸2にシール 材 (52m Ø × 2.3 m × 2.3 m) 1を装着し、相 手材3をADC-12とし、回転数0~700 r pm、油圧0~9 kg/cd、油温110~120 c の条件下にて、油4 (フレオールS83、共同石 油社製)を導入して油漏れ量を測定した。

(伸び)

オートグラフAGB型 (島津社製) により測定 した。

(動摩擦係數)

上記速度(V)を2m/秒に設定し、圧力(P)

を1 は/ ロずつ2時間ごとに増加させて、試料の PV限界(動摩擦係数の急激な変動時あるいは試 料の異常摩耗時)値を測定し、その動摩擦係数を 測定した。

第1表から明らかなように、ポリイミド初末が 5~50重量%含有されてなるシール材は摩耗量 が少なく、またシール性にすぐれていることが判

(以下、余白)

伸び 動摩弦係数 (%)	2 0 0 0.16~0.22	1 5 0 0.22~0.28	1 0 0 0.20~0.28	3 0 0 0.06~0.10	4 0 0.22~0.33	1 7 3 0.21~0.31	2 3 0 0.25~0.35	6 5 0.26~0.33	6 0 0.27~0.36
油油れ量 (cc/hr)	5.8	3. 1	9.8	6 2 1. 5	2 6.5	2 8.4	3 3.8	4 2. 1	48.4
级膨强保数 (×10.3)	1 0.8	8.0	5.6	1 3.6	5. 3	1 2.8	1 5.2	8. 2	7.8
(加)相手材	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0. 1	0. 1	0.3	0.1	0.1
解析器シール材	2 0	80	3 3	7 0 0 0	120	2 0 0	992	8 6	1 1 0
	一二	施 2	<u>چ</u>	-	7 11	en	*	\$	9

4.図面の簡単な説明

第1図は実施例においてシール性を測定する際のシール材装着状態図、第2図はシール性の測定 結果を示すグラフである。

1 …シール材、2 …アルニミウム軸、3 …相手材、4 …油

特許出願人 日東電気工業株式会社 代表者 鎌居 五朗

特開平1-311155(プ)

